PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10186351 A

(43) Date of publication of application: 14.07.98

(51) Int. Cl

G02F 1/1335 G02F 1/136

(21) Application number: 08343023

(22) Date of filing: 24.12.96

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

OTA MASUYUKI

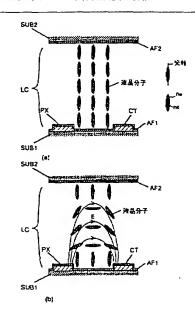
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract;

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a wide visual field angle comparable with a cathode-ray tube and a high-speed response capable of coping with moving picture, and to maintain satisfactory picture quality, by providing orientation control films, electrode structures, specific polarizing plates, and modulating the transmissivity of the light beam passing a liquid crystal composition with an electric field.

SOLUTION: This liquid crystal display device is provided with one pair of substrates, a liquid crystal composition having positive dielectric constant anisotropy, orientation control films orienting optical axes of liquid crystal molecules being in the liquid crystal composition roughly vertically with respect to the substrates, one pair of electrode structure generating an electric field roughly parallel with surfaces of the one pair of the substrates and one pair of polarizing plates in which the angle between an electric field component parallel with the surfaces of the substrates and the light transmission axis of one side is roughly 45 degrees and the light transmission axis of other side is positioned in crossed Nicols at roughly 90 degrees with the light transmission axis of one side and then the transmissivity of the light transmitting the liquid crystal composition is modulated with the electric field. That is, the transmissivity is controlled by controlling the refractive index anisotropy of the liquid crystal layer with the impressing of a voltage. A double refraction phase difference is not generated at the time of a voltage non-impression. Since optical axes of liquid crystal molecules become parallel with the surfaces of the substrates at the time of a voltage impression, the liquid crystal layer presents the maximum refractive index anisotropy with respect to an incident light.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-186351

(43)公開日 平成10年(1998)7月14日

(51) Int. C1. ° G O 2 F 1/1335

1/136

識別記号 510 500 FI

G O 2 F 1/1335 5 1 0

1/136 500

審査請求 未請求 請求項の数5

ΟL

(全19頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平8-343023

平成8年(1996)12月24日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 太田 益幸

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所電子デバイス事業部内

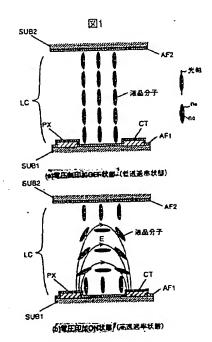
(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54)【発明の名称】液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】ブラウン管並の広視野角かつ高速応答を実現でき、かつ、高画質、高信頼性の液晶表示装置を提供する

【解決手段】一対の基板と、一対の基板に挟持された正 の誘電率異方性を有する液晶組成物と、電圧無印加時に 液晶組成物層中の略全ての液晶分子の光軸を基板面に配 向させ得る配向制御膜と、液晶組成物層に一対の基板の 基板面に略<u>工行な電界を印加る世界</u>る一対の電極を有 し、液晶組成物層を透過する光の透過率を変調する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の基板と、前記一対の基板に挟持され た正の誘電率異方性を有する液晶組成物と、電圧無印加 時に前記液晶組成物層中の液晶分子の光軸を基板面に略 垂直に配向させ得る配向制御膜と、前記液晶組成物層に 前記一対の基板の基板面に略平行な電界を発生させる一 対の電極構造と、前記基板面に平行な電界成分と一方の 光透過軸との間の角度が約45度で、他方の光透過軸が 一方の光透過軸と約90度でクロスニコル位置される一 過する光の透過率を変調することを特徴とする液晶表示 装置。

【請求項2】多数の走査配線と、多数の信号配線と、前 記多数の走査配線と前記多数の信号緯線に各々の略交点 に形成された能動素子と、前記一対の基板の基板面に略 平行な電界を発生させ得る一対の電極を有することを特 徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】多数の走査配線と、多数の信号配線と、前 記多数の走査配線と前記多数の信号緯線に各々の略交点 に形成された薄膜トランジスタ素子と、前記一対の基板 の基板面に略平行な電界を発生させ得る一対の電極を有 することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項4】不要な光漏れ部分を遮光し絶縁性を有する プラックマトリクスを有することを特徴とする請求項1 記載の液晶表示装置。

【請求項5】前記一対の基板の前記液晶組成物の挟持面 の反対側の基板面の少なくとも一方の基板面上に透明導 電膜を有することを特徴とする請求項1記載の液晶表示 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に関 し、特に動画を表示し高画質の映像が必要なシステムの 表示デバイスに用いる。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は薄い、軽量という特徴か らノートパソコンに代表される携帯機器の表示装置とし て広く普及している。特に薄膜トランジスタ素子(TF T) に代表される能動素子を用いたアクティブマトリク ス型液晶表示装置は、ブラウン管に匹敵する高面質とい 40 う点から、最近では、デスクトップパソコンのモニター およびOA機器等の表示端末として広く普及し始めてい る。しかしながら、液晶表示装置には、視野角が狭い、 応答速度が遅いという特有の欠点が存在する。これらを 解決す手段として、例えば、視野角を改善する方法とし て提案されているのが、インプレーンスイッチングモー ドと呼ばれる表示モードであり、視野角は抜本的に改善 される。また、応答速度を改善させる方法としては、例 えば、オプティカルコンペンセーティドペンディング

れらに関しては、インプレーンスイッチングモードに関 しては、例えば、「R. Kiefer、 B. Webe r, F. Windcheidand G. Baur, Proceedings of the Twelf th International Display Research Conference (Japa n Display '92) pp. 547~55 0」、オプティカルコンペンセーティドベンディングモ ード (OCB) に関しては、例えば、「T. Uchid 対の偏光板とを有し、前記電界で前記液晶組成物層を透 10 a and T. Miyashita、Proceed ings of The 2nd Internati onalDisplay Workshops (ID W '95) pp. 39~42」、垂直配向モードに 関しては、例えば、「日経マイクロデバイス、1996 年10月号、p147」がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記イ ンプレーンスイッチングモードを利用する液晶表示装置 では、応答速度が速いものでも100ms弱程度であ り、動画表示を行うために必要とされる40~20ms 以下の応答速度には程遠く、動画表示を行った時に動画 の残像が発生し、画像が彗星の様に尾を引いて流れるよ うに見えるという問題がある。

【0004】一方、オプティカルコンペンセーティドベ ンディングモードでは、液晶のベンド配向を実現させる のが、極めて難しく、実用化に至っていない。

【0005】また、垂直配向モードでは、上下方向の視。 。野角が悪く、配向分割技術を使わなげれならず、配向分 割を施すために、液晶分子のプレチルトを2方向にする 30 ような処理が必要で、垂直配向の状態で、2方向のプレ チルトの状態を安定に維持することが難しく、長時間輝 度均一性を維持できないという点で、信頼性に問題があ った。

【0006】本発明は上記の課題を解決するもので、本 発明の目的は、ブラウン管並の広い視野角、かつ、動画 に対応できる高速応答を有し、かつ、良好な画質を長時 間安定的に維持できる高信頼性のアクティブマトリクス 型液晶表示装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、本発明では、第1の構成として、一対の基板と、前 記一対の基板に挟持された正の誘電率異方性を有する液 晶組成物と、電圧無印加時に前記液晶組成物層中の液晶 分子の光軸を基板面に略垂直に配向させ得る配向制御膜 と、前記液晶組成物層に前記一対の基板の基板面に略平 行な電界を発生させる一対の電極構造と、前記基板面に 平行な電界成分と一方の光透過軸との間の角度が約45 度で、他方の光透過軸が一方の光透過軸と約90度でク ロスニコル位置される一対の偏光板とを有し、前記電界 (OCB) モード<u>垂直配向 (VA) モード</u>がある。こ 50 で前記被晶組成物層を透過する光の透過率を変調するこ

とを特徴とする。

【0008】第2の構成として、第1の構成を含み、多 数の走査配線と、多数の信号配線と、前記多数の走査配 線と前記多数の信号線線に各々の略交点に形成された能 動素子と、前記一対の基板の基板面に略平行な電界を発 生させ得る一対の電極を有する構成とする。

【0009】第3の構成として、第1の構成を含み、多 数の走査配線と、多数の信号配線と、前記多数の走査配 線と前記多数の信号緯線に各々の略交点に形成された薄 膜トランジスタ素子と、前記一対の基板の基板面に略平 10 の初期状態では、入射光に対して複屈折位相差が発生し 行な電界を発生させ得る一対の電極を有する構成とす

【0010】第4の構成として、第1の構成を含み、不 要な光漏れ部分を遮光し絶縁性を有するブラックマトリ クスを有する構成とする。

【0011】第5の構成として、第1の構成を含み、前 記一対の基板の前記液晶組成物の挟持面の反対側の基板 面の少なくとも一方の基板面上に透明導電膜を有する構 成とする。

【0012】図1、図2に本発明の原理図を示す。

ここで、Tは出射光強度、T。は入射光強度、xは液晶 分子と光軸(液晶層の実効的光軸)と偏光板の偏光透過 軸とのなす角、Δnは液晶層の屈折率異方性、λは入射 光の波長、dは基板間の間隔(液晶層の実効的厚み)、 πは円周率を表す。

【0017】ここで、本発明では、図3に示すように偏 光板と液晶分子と光軸のなす角 x は 4 5 度でとすると、 式1の第1項が1となるので、第2項により透過率T/ T。が決定される。

【0018】したがって、本発明では、電圧の印加によ り液晶層の△nを制御し、式1の第2項を変化させ、透 過率を制御し、所望の表示を得るものである。図1、図 2に戻って説明すると、全仏紙印加時には複屈折位相差 が発生しない、すなわち、屈折率異方性 Anが Oであ り、透過率は0となる。このとき視角方向を変化させて も、本発明の様に垂直配向した状態では複屈折位相差が 発生しないので、全視角方向で良好なのである。

【0019】一方、電圧印加時には、液晶分子の光軸が 40 基板面に平行になり入射光に対し最大の屈折率異方性を 表す。このとき、液晶の屈折率異方性Anと液晶層の厚 みdの積(リタデーション)を入射光えの1/2に設定 すれば、透過率は最大となり、白表示を得ることができ

【0020】ここで、本発明が従来の垂直配向モードと 異なる点は、本発明では、液晶組成物層に一対の基板の 基板面に欧平行な電界を印加するための電極構成によ 晶分子の動作が2方向に別れるため、従来の垂直配向

*【0013】図1は本発明の液晶表示装置の1つの面素 の表示部の断面を、基板面に平行な方向から見た図であ り、図2は基板面に垂直な方向から見た図である。な お、図1、図2説明の簡略化のために、TFT等の素子 は省略している。

【0014】図1 (a)、図2 (a) に示すように、本 発明では、電界無印加時に液晶組成物層の中の殆どの液_ 晶分子の長軸 (光軸) を基板面に垂直な方向に配列する ように配向制御膜(配向膜)で初期状態を制御する。こ

【0015】この液晶組成物層に基板に形成された価値 電極により基板面に平行な電界を印加することにより、 図1 (b)、図2 (b)の様に液晶分子の長軸を基板面 に平行な方向に配列させる。これにより液晶組成物中を 通過する光に対し複屈折位相差が発生し、光が変調され る。ここで、図3に示す偏光板の配置により、本発明の 液晶表示装置の表示を通過する光の透過率T/T。は、 以下のようになる。

*20 - [0016]

 $T/T_0 = s i n^2 (2 \chi) s i n^2 (\pi \Delta n \cdot d/\lambda) \cdots (\exists l)$

で、白表示の視野角特性を広げるために行っている配向 <u>分割</u>を施すことが<u>不必要</u>であり、それにともなって問題 となっていた配向安定性が向上し、長時間高面質を維持 できる高信頼性を得ることができることである。

【0021】したがって、高コントラスト比が得られ、 かつ、広視野角特性を得られると同時に、高画質を維持 できる高信頼性を両立できる。

【0022】また、【第2の作用として、配向膜と液晶の 界面での、液晶分子を固定する力(アンカリング)が小 さいため、液晶分子が、液晶層内で動き易く、そのた め、応答速度が極めて速くなる。

【0023】さらに、第3の作用として、従来の垂直配 向モードでは、高い透過率状態 (白表示) を得るため に、液晶分子の光軸を基板面に平行な方向に動かすため に、電界と垂直方向に光軸を揃える性質を有する負の誘 電異方性 (Δε<0) の液晶組成物を使う必要がある が、本発明では、液晶組成物層に一対の基板の基板面に 略平行な電界を印加することにより、高い誘電率異方性 が得られ、低電圧で駆動可能な正の誘電異方性(Δε> 0) を有する液晶組成物 (正の誘電異方性を有する液晶 は電界方向と同方向に光軸を揃える)を使用することが できる。

【0024】また、第4の作用として、印加電界の方向 で、液晶分子の光軸の基板面に平行な面内での方向が決 定されるため、従来の垂直配向モードで行っていたラビ ング処理等での配向方向制御が不必要である。これによ り、その配向規制力による液晶分子の動きにくさも改善 でき、さらに応答速度を向上することができる。

【0025】これらの作用により、インプレーンスイッ

チングモードで実現できない高速応答と、垂直配向モードで実用化できない<u>広視野角</u>と高信頼性の両立を、全て解決することができ、極めて高画質で、ブラウン管を凌駕できる理想的な液晶表示装置を実現することができる。

[0026]

【発明の実施の形態】本発明、本発明の更に他の目的及び本発明の更に他の特徴は図面を参照した以下の実施例の説明から明らかとなるであろう。

【0027】《アクティブ・マトリクス液晶表示装置》以下、アクティブ・マトリクス方式のカラー液晶表示装置に本発明を適用した実施例を説明する。なお、以下説明する図面で、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

【0028】《マトリクス部(画茶部)の平面構成》図 4 仕本発明のアクティブ・マトリクス方式カラー液晶表 示装置の一両素とその周辺を示す平面図である。

【0029】図4に示すように、各画素は走査信号線(ゲート信号線または水平信号線)GLと、対向電圧信号線(対向電極配線)CLと、解接する2本の映像信号線(ドレイン信号線または垂直信号線)DLとの交差領域内(4本の信号線で囲まれた領域内)に配置されている。各画素は薄膜トランジスタTFT、蓄積容量Cst8、画素電極PXおよび対向電極CTを含む。走査信号線GL、対向電圧信号線CLは図では左右方向に延在し、上下方向に延在し、左右方向に複数本配置されている。映像信号線DLは上下方向に延在し、左右方向に複数本配置されている。画素電極PXはソース電極SD1を介して薄膜トランジスタTFTと電気的に接続され、対向電極CTも対向電圧信号線CLと電気的に接続されている。

【0030】 画素電極PXと対向電極CTは互いに対向 し、各画素電極PXと対向電極CTとの間で発生させら れる基板面に略平行な電界により液晶組成物LCの光学 的な状態を制御し、表示を制御する。画素電極PXと対 向電極CTは櫛歯状に構成され、それぞれ、図の上下方 向に長細い電極となっている。

【0031】1画素内の対向電極CTの本数O(櫛歯の本数)は、画素電極PXの本数(櫛歯の本数)PとO=P+1の関係を持つように構成する(本実施例では、O=3、P=2)。これは、対向電極CTと画素電極PXを交互に配置し、かつ、対向電極CTを映像信号線DLに隣接させるためである。これにより、対向電極CTと画素電極PXの間の電界が、映像信号線DLから発生する電界から影響を受けないように、対向電極CTと画素電極PXの間の電界が、映像信号線DLから発生する電界から影響を受けないように、対向電極CTで映像信号線DLからの不要な電気力線をシールドすることができる。対向電極CTは、画素電極と異なり、後述の対向電圧信号線CLにより常に外部から電位を供給されているため電位は安定しており、映像信号線DLに隣接しても電位が変動がほとんどない。したがって、映像信号線DLからの不要な電気力線をシールドすることができ

る。また、画素電極PXの映像信号線DLからの幾何学的な位置が違くなるので、画素電極PXと映像信号線DLの間の寄生容量が大幅に減少し、画素電極電位Vsの映像信号電圧による変動も抑制できる。これらにより、上下方向に発生するクロストーク(擬スミアと呼ばれる画質不良)を抑制することができる。

【0032】画素電極PXと対向電極CTの電極幅はそ れぞれ6μωとする。これは、液晶層の厚み方向に対し て、液晶層全体に十分な電界を印加するために、後述の 液晶組成物層の厚み3.9μωよりも十分大きく設定す る。望ましくは、液晶組成物層の1.5倍以上に設定す る。また、開口率を大きくするためにできるだけ細くす る。また、映像信号線 D L も 6 μ m と する。映像信号線 DLの電極幅は断線を防止するために、画素電極PXと 対向電極CTに比較して若干広しても良い。但し、映像 信号線DLの電極幅が、隣接する対向電極CTの電極幅 の2倍以下になるように設定する。映像信号線DLの電 極幅が歩留りの生産性から決まっている場合には、映像 信号線DLに隣接する対向電極CTの電極幅を映像信号 線DLの電極幅の1/2以上にする。これは、映像信号 線DLから発生する不要な電気力線をそれぞれ両脇の対 向電極CTで吸収するためであり、ある電極幅から発生 する電気力線を吸収するには、それと同一幅以上のの電 極幅を持つ電極が必要である。したがって、映像信号線 DLの電極の半分(4μπずつ)から発生する電気力線 をそれぞれ両脇の対向電極CTが吸収しればよいため、 映像信号線DLに隣接する対向電極CTの電極幅が1/ 2以上とする。これにより、映像信号の影響によるクロ ストークが発生、特に上下方向(縦方向)のクロストー 30 クを防止する。

【0033】走査信号線GLは末端側の画素(後述の走査電極端子GTMの反対側)のゲート電極GTに十分に走査電圧が伝搬されるだけの抵抗値を満足するように電極幅を設定する。また、対向電圧信号線CLも末端側の画案(後述の共通パスラインCB1およびCB2から最も遠い画素すなわちCB1とCB2の中間の画素)の対向電極CTに十分に対向電圧が印加できるだけの抵抗値を満足するように電極幅を設定する。

【0034】一方、画素電極PXと対向電極CTの間の 電極間隔は、用いる液晶材料によって変える。これは、 液晶材料によって最大透過率を達成する電界強度が異な るため、電極間隔を液晶材料に応じて設定し、用いる映 像信号駆動回路(信号側ドライバ)の耐圧で設定される 信号電圧の最大振幅の範囲で、最大透過率が得られるよ うにするためである。後述の液晶材料を用いると電極間 隔は、16μmとなる。

【0035】《マトリクス部(画素部)の断面構成》図 5社図4の6-6切断線における断面を示す図、図6は 図4の7-7切断線における薄膜トランジスタTFTの 50 断面図、図では図4の8-8切断線における蓍積容量C

stgの断面を示す図である。図5~図7に示すように、 液晶組成物層LCを基準にして下部透明ガラス基板SU B1側には薄膜トランジスタTFT、蓄積容量Cstgお よび電極群が形成され、上部透明ガラス基板SUB2側 にはカラーフィルタFIL、適当用ブラックマナリクス× → Am→ BMが形成されている。

【0036】また、透明ガラス基板SUB1、SUB2 のそれぞれの内側 (液晶LC側) の表面には、液晶の初 期配向を制御する配向膜AF1、AF2が設けられてお り、透明ガラス基板SUB1、SUB2のそれぞれの外 側の表面には、偏光板が設けられている。

【0037】《TFT基板》まず、下側透明ガラス基板 SUB1側(TFT基板)の構成を詳しく説明する。

【0038】《薄膜トランジスタTFT》薄膜トランジ スタTFTは、ゲート電極G Tに正のバイアスを印加す ると、ソースードレイン間のチャネル抵抗が小さくな り、バイアスを零にすると、チャネル抵抗は大きくなる ように動作する。

【0039】薄膜トランジスタTFTは、図6に示すよ うに、ゲート電極GT、絶縁膜GI、i型(真性、intr 20 insic、導電型決定不純物がドープされていない) 非晶 質シリコン(Si)からなるi型半導体層AS、一対の ソース電極SD1、ドレイン電極SD2を有す。なお、 ソース、ドレインは本来その間のパイアス極性によって 決まるもので、この液晶表示装置の回路ではその極性は 動作中反転するので、ソース、ドレインは動作中入れ替 わると理解されたい。しかし、以下の説明では、便宜上 一方をソース、他方をドレインと固定して表現する。

【0040】 ***** ト電極G T »・ゲート電極G T は走査 信号線GLと連続して形成されており、走査信号線GL の一部の領域がゲート電極GTとなるように構成されて いる。ゲート電極GTは薄膜トランジスタTFTの能動 領域を超える部分である。本例では、ゲート電極GT は、単層の導電膜g3で形成されている。導電膜g3と しては例えばスパッタで形成されたクロムーモリブデン 合金(GazzMo)。膜が用いられるがそれに限ったもの ではない。

【0041】《走査信号線GL》走査信号線GLは導電 膜g3で構成されている。この走査信号線GLの導電膜 g 3 はゲート電極G T の導電膜 g 3 と同一製造工程で形 40 る。この交差部の i 型半導体層 A S は交差部における走 成され、かつ一体に構成されている。この走査信号線G しにより、外部回路からゲート電圧(走査電圧)Vgを ゲート電極GTに供給する。本例では、導電膜g3とし ては例えばスパッタで形成されたクロムーモリブデン合 金(Cr-Mo)膜が用いられる。また、走査信号線G Lおよびはゲート電極G Tは、クロムーモリブデン合金 のみに限られたものではなく、たとえば、低抵抗化のた めにアルミニウムまたはアルミニウム合金をクロムーモ リブデンで包み込んだ2層構造としてもよい。

映像信号線DLとの短絡の確率を小さくするため細く し、また、短絡しても、レーザートリミングで切り離す ことができるように二股にしても良い。

Я

【0043】《対向電圧信号線CL》対向電圧信号線C Lは導電膜g3で構成されている。この対向電圧信号線 CLの導電膜g3はゲート電極GT、走査信号線GLお よび対向電極CTの導電膜g3と同一製造工程で形成さ れ、かつ対向電極CTと電気的に接続できるように構成 されている。この対向電圧信号線CLにより、外部回路 10 から対向電圧Vcomを対向電板CTに供給する。また、対 向電圧信号線CLは、クロムーモリブデン合金のみに限 られたものではなく、たとえば、低抵抗化のためにアルミ ニウムまたはアルミニウム合金をクロムーモリブデンで 包み込んだ2層構造としてもよい。さらに、映像信号線 DLと交差する部分は映像信号線DLとの短絡の確率を 小さくするため細くし、また、短絡しても、レーザート リミングで切り離すことができるように二股にしても良

【0044】《絶縁膜GI》絶縁膜GIは、薄膜トラン ジスタTFTにおいて、ゲート電板GTと共に半導体層 ASに電界を与えるためのゲート絶縁膜として使用され る。絶縁膜GIはゲート電極GTおよび走査信号線GL の上層に形成されている。絶縁膜GIとしては例えばブ ラズマCVDで形成された窒化シリコン膜が選ばれ、2 000~4500Aの厚さに(本実施例では、3500 A程度) 形成される。また、絶縁膜GIは走査信号線G Lおよび対向電圧信号線CLと映像信号線DLの層間絶 緑膜としても働き、それらの電気的絶縁にも寄与してい

【0045】《Li型半導体層AS》i型半導体層AS 30 は、非晶質シリコンで、150~2500名の厚さに (本実施例では、1200 A程度の膜厚) で形成され る。層d0はオーミックコンタクト用のリン(P)をド ープしたN(+)型非晶質シリコン半導体層であり、下側 に i 型半導体層ASが存在し、上側に導電層 d 3 が存在 するところのみに残されている。

【0046】i型半導体層ASおよび層d0は、走査信 号線GLおよび対向電圧信号線CLと映像信号線DLと の交差部 (クロスオーバ部) の両者間にも設けられてい 査信号線G Lおよび対向電圧信号線C L と映像信号線 D しとの短絡を低減する。

【0047】《ソース電極SD1、ドレイン電極SD 2》ソース電極SD1、ドレイン電極SD2のそれぞれ は、N(+)型半導体層d0に接触する導電膜d3から構 成されている。

【0048】導電膜d3はスパッタで形成したクロムー モリブデン合金 (Cr-Mo) 膜を用い、500~30 00Aの厚さに(本実施例では、2500A程度)で形 【0042】さらに、映像信号線DLと交差する部分は 50 成される。Cr-Mo膜は低応力であるので、比較的膜

厚を厚く形成することができ配線の低抵抗化に寄与す る。また、Cr~Mo膜はN(+)型半導体層d0との接 着性も良好である。導電膜 d 3 として、CェーMo膜の 他に高融点金属 (Mo、Ti、Ta、W) 膜、高融点金 属シリサイド (MoSiz、TiSiz、TaSiz、W Si₂)膜を用いてもよく、また、アルミニウム等との積 層構造にしてもよい。

【0049】《映像信号線DL》映像信号線DLはソー ス電極SD1、ドレイン電極SD2と同層の導電膜d3 で構成されている。また、映像信号線DLはドレイン電 10 さに(本実施例では、1400A程度の模厚)形成され 極SD2と一体に形成されている。本例では、導電膜d 3はスパッタで形成したクロムーモリブデン合金(Cr -Mo) 膜を用い、500~3000Åの厚さに(本実 施例では、2500 A程度) で形成される。Cr-Mo 膜は低応力であるので、比較的膜厚を厚く形成すること ができ配線の低抵抗化に寄与する。また、Cr-Mo膜 はN(+)型半導体層 d O との接着性も良好である。 導電 膜d3として、Cr-Mo膜の他に高融点金属(Mo、 Ti、Ta、W) 膜、高融点金属シリサイド (MoSi 2、TiSi2、TaSi2、WSi2)膜を用いてもよ く、また、アルミニウム等との積層構造にしてもよい。 【0050】《蓄積容量Cstg》導電膜d3は、薄膜ト ランジスタTFTのソース電極SD2部分において、対 向電圧信号線CLと重なるように形成されている。この 重ね合わせは、図7からも明らかなように、ソース電極 SD2 (d3)を一方の電極とし、対向電圧信号CLを 他方の電極とする蓄積容量(静電容量素子)Cstgを構 成する。この蓄積容量Cstgの誘電体膜は、薄膜トラン ジスタTFTのゲート絶縁膜として使用される絶縁膜G 1で構成されている。

【0051】図4に示すように平面的には蓄積容量Cst gは対向電圧信号線CLの一部分に形成されている。

【0052】《保護膜PSV1》薄膜トランジスタTF T上には保護膜PSV1が設けられている。保護膜PS V1は主に薄膜トランジスタTFTを湿気等から保護す るために形成されており、透明性が高くしかも耐湿性の 良いものを使用する。保護膜PSViはたとえばプラズ マCVD装置で形成した酸化シリコン膜や窒化シリコン 膜で形成されており、0.1~1μm程度の膜厚で形成 する。

【0053】保護膜PSV1は、外部接続端子DTM、 GTMを露出するよう除去されている。保護膜PSV1 と絶縁膜GIの厚さ関係に関しては、前者は保護効果を 考え厚くされ、後者はトランジスタの相互コンダクタン スgmを薄くされる。

【0054】また、画素部では、対向電圧信号線CLと 後述の対向電極CTとの電気的接続、および、ソース電 極SD2と面素電極PXとの電気的接続のために、スル ーホールTH2およびTH1を設けている。スルーホー ルTH2では、保護膜PSV1と絶縁膜G1が一括で加 50 またはパックライト光がi型半導体層ASに入射しない

工されるのでg3層までの孔があき、スルーホールTH 1ではd3でブロッキングされるのでd3層までの孔があ ۷.

【0055】また、保護膜PSV1は、ポリイミド等の 有機膜を厚く構成したものとの積層構造としても良い。 【0056】《画素電極PX》画素電極PXは、透明導 電層 i 1 で形成されている。この透明導電膜 i 1 はスパ ッタリングで形成された透明導電膜 (Indium-Tin-Oxide ITO:ネサ膜) からなり、100~2000Aの厚 る。また、画素電極PXはスルーホールTH1を介し て、ソース電極SD2に接続されている。

【0057】 画素電極が本実施例のように透明になるこ とにより、その部分の透過光により、白表示を行う時の 最大透過率が向上するため、画素電極が不透明な場合よ りも、より明るい表示を行うことができる。この時、後 述するように、電圧無印加時には、液晶分子は初期の配 向状態を保ち、その状態で黒表示をするように偏光板の 配置を構成する(ノーマリブラックモードにする)にし 20 ているので、画素電極を透明にしても、その部分の光を 誘過することがなく、良質な黒を表示することができ る。これにより、最大透過率が向上させ、かつ十分なコ ントラスト比を達成することができる。

【0058】《村内電極CT》対向電極CTは透明導電 層i1で形成されている。この透明導電膜i1はスパッ タリングで形成された透明導電膜 (Indium-Tin-Oxide ~ITO:ネサ膜) からなり、100~2000Aの厚さ に (本実施例では、1400 A程度の膜厚) 形成され る。また、対向電極CTはスルーホールTH2を介し 30 て、対向電圧信号線CLに接続されている。面素電極P Xと同様、対向電極を透明にすることにより、白表示を 行う時の最大透過率が向上する。

【0059】対向電極CTには対向電圧Vcomが印加さ れるように構成されている。本実施例では、対向電圧V comは映像信号線DLに印加される最小レベルの駆動電 圧Vdminと最大レベルの駆動電圧Vdmaxとの中間直流 電位から、薄膜トランジスタ素子TFTをオフ状態にす るときに発生するフィードスルー電圧ΔVs分だけ低い 電位に設定されるが、映像信号駆動回路で使用される集 40 積回路の電源電圧を約半分に低減したい場合は、交流電 圧を印加すれば良い。

【0060】《カラーフィルタ基板》次に、図4、図5 に戻り、上側透明ガラス基板SUB2側(カラーフィル 夕基板) の構成を詳しく説明する。

《意光順日M》上部透明ガラス基板SUB2側には、不 要な間隙部(画素電極PXと対向電極CTの間以外の隙 間) からの透過光が表示面側に出射して、コントラスト 比等を低下させないように遮光膜BM(いわゆるブラッ クマトリクス)を形成している。遮光膜BMは、外部光

ようにする役割も果たしている。すなわち、薄膜トラン ジスタTFTのi型半導体層ASは上下にある遮光膜B Mおよび大き目のゲート電極GTによってサンドイッチ にされ、外部の自然光やバックライト光が当たらなくな

【0061】図4に示す遮地膜BMは、薄膜トランジス タ素子TFT上部に左右方向に線状に延在した構成であ る。このパターンは、1例であり、開口部を孔状にあけ たマトリクス状の様にすることもできる。櫛笛電極端部 等の電界方向が乱れる部分においては、その部分の表示 10 表面にアクリル系樹脂等の染色基材を形成し、フォトリ は、画素内の映像情報に1対1で対応し、かつ、黒の場 合には黒、白の場合には白になるため、表示の一部とし て利用することが可能である。また、図の上下方向にお ける対向電極CTと映像信号線DLとの間隙部は、ゲー ト電極GTと同一工程で形成した第2遮光層SHで遮光 する。これにより左右方向の上下方向の遮光は、TFT 工程のアライメント精度で高精度に遮光できるので、映 像信号線DLに隣接する対向電極CTの電極間に第2遮 光層SHの境界を設定でき、上下基板のあわせ精度に依 存する遮光膜BMによる遮光よりも、より開口部を拡大 20 光膜BMによる段差の平坦化のために設けられている。 することができる。

【0062】また、遮光膜BMを薄膜トランジスタ基板 SUB1上に形成することもできる。これにより、第2 遮光層SH同様、上下基板のあわせ精度に依存する基板 SUB 2上の遮光膜BMによる遮光よりも、より開口部 を拡大することができる。

【0063】但し、産光膜B-Mは光に対する遮蔽性を有 し、かつ、画素電板PXと対向電極CTの間の電界に影 響を与えないように絶縁性の高い膜で形成されており、 本実施例では黒色の有機顔料をレジスト材に混入し、 1.2μ μ程度の厚さで形成している。また、光に対する 遮蔽性を向上させるためにカーボン、チタン酸化物(T i ×Oy) を、絶縁性が液晶組成物層内の電界に影響を 与えない108Qcm以上を維持できる範囲で、混入さ せても良い。また、第2遮光層SHは映像信号線からの 電気力戦を吸収しやすい様に、導電性を有するほうが良

【0064】遮光膜BMは各行の画素に左右方向に線状 に形成され、この線で各行の有効表示領域が仕切られて いる。従って、各行の画案の輪郭が遮光膜BMによって 40 は、垂直配向処理を施したポリマビーズで制御してい はっきりとする。つまり、遮光膜BMは.ブラックマト リクスとi型半導体層ASに対する遮光との2つの機能 をもつ。

【0065】遮光膜BMは周辺部にも額縁状に形成さ れ、そのパターンは図4に示すマトリクス部のパターン と連続して形成されている。周辺部の遮光膜BMは、シ ール部SLの外側に延長され、パソコン等の実装機に起 因する反射光等の漏れ光がマトリクス部に入り込むのを 防いぐと共に、バックライト等の光が表示エリア外に漏 れるのも防いでいる。他方、この遮光膜BMは基板SU 50 【0073】また、液晶組成物の比抵抗としては、10

B 2 の緑よりも約0.3~1.0mm程内側に留めら れ、基板SUB2の切断領域を避けて形成されている。 【0066】. 《カラーフィルタF1L》カラーフィル タFILは面素に対向する位置に赤、緑、青の繰り返し でストライプ状に形成される。カラーフィルタFILは 2重遮光膜SHのエッジ部分と重なるように形成されて いる。

12

【0067】カラーフィルタFILは次のように形成す ることができる。まず、上部透明ガラス基板SUB2の ソグラフィ技術で赤色フィルタ形成領域以外の染色基材 を除去する。この後、染色基材を赤色顔料で染め、固着 処理を施し、赤色フィルタRを形成する。つぎに、同様 な工程を施すことによって、緑色フィルタG、青色フィ ルタBを順次形成する。なお、染色には染料を用いても よい。

【0068】《オーバーコート膜OC》オーバーコート 膜OCはカラーフィルタFILの染料の液晶組成物層L Cへの漏洩の防止、および、カラーフィルタFIL、遮 オーバーコート膜OCはたとえばアクリル樹脂、エポキ シ樹脂等の透明樹脂材料で形成されている。また、オー パーコート膜オCとして、流動性の良いポリイミド等の 有機膜を使用しても良い。

【0069】《液晶層および偏向板》次に、液晶層、配 向膜、偏光板等について説明する。

【0070】《液晶層》液晶組成物LCとしては、誘電 卒異方性Δεが正でその値が13.2、屈折率異方性Δ nが0.081 (589nm、20℃) のネマティック 30 液晶を用いる。液晶組成物層の厚み(ギャップ)は、 3. 8μ mとし、リタデーション Δ n・dは0. 31μ mとする。このリタデーションΔn・dの値は、0.2 5 μ m以上から 0.35 μ m の間、好ましくは、0.2 8μm以上から0.32μmの間に設定し、後述の偏光 板と組み合わせにより、液晶分子の光軸が電界方向に配 列したとき最大透過率を得ることができ、可視光の範囲 ないで波長依存性がほとんどない透過光を得ることがで きるようにする。

【0071】また、液晶組成物層の厚み(ギャップ) る。これにより、黒表示時のビーズ周辺の液晶分子の配 向を安定化し、良好な黒レベルを得、コントラスト比を 向上している。

【0072】なお、液晶材料しては、特に限定したもの ではなく、誘電率異方性Δεは、その値が大きいほう が、駆動電圧が低減でき、屈折率異方性Anは小さいほ うが、液晶層の厚み(ギャップ)を厚くでき、液晶の封 入時間が短縮され、かつギャップはらつきを少なくする ことができる。

[®]Ω c m以上10 ¹⁴Ω c m以下、好ましくは10 ¹¹ Ω c m以上10 1 3 Ω c m以下のものを用いる。本方式 では、液晶組成物の抵抗が低くても、面素電極と対向電 極間に充電された電圧を十分保持することができ、その 下限は10°Ωcm、好ましくは10'1Ωcmであ る。これは、面素電極と対向電極を、同一基板上に構成 していることによる。また、抵抗が高すぎると、製造工 程上に入った静電気を緩和しにくいため、10゚ ⁴Ωc m以下、好ましくは10¹³Ωcm以下が良い。

【0074】《配向膜》配向膜AFとしては、日本合成 ゴム(株)製ポリイミド(JALS203)を用いる。こ の配向膜は表面に疎水基(例えばCH3)が存在し、液 **晶分子の長軸(光軸)が基板面に垂直方向に配列させる** ものである。これにより、電界無印加時に後述の偏光板 との組み合わせにより、良好な黒レベルを表示する。ま た、本発明では、ラビング処理は施さない。このため、 ラビング処理に関わるラビングされない部分ができるこ とによる表示不良領域の発生によるコントラスト比の低 下や、ラビング角度のばらつきによるむらの発生等の不 良をなくすことができる。

【0075】《偏光板》偏光板POLとしては、導電性 を有する偏光板を用い、下側の偏光板 POL1の偏光透 過軸MAX1を電界印加方向(櫛歯電極の長手方向と直 交する方向) に対して約45度の角度に設定し、上側の 偏向板POL2の偏光透過軸MAX2を、それに直交さ せる。図3にその関係を示している。これにより、作用 に示した様な表示を行うことができ、印加される電圧

(画素電極PXと対向電極CTの間の電圧)を増加させ るに伴い、透過率が上昇するノーマリクローズ特性を得 ることができる。

【0076】なお、本実施例では、偏光板に導電性を持 たせることにより、外部からの静電気による表示不良お よびEMI対策を施している。導電性に関しては、静電 気による影響を対策するためだけであれば、シート抵抗 が10°Q/ロ以下、EMIに対しても対策するのであ れば、10 4 Ω/ロ以下とするのが望ましい。また、ガ ラス基板の液晶組成物の挟持面の裏面(偏光板を粘着さ せる面) に導電層を設けてもよい。

【0077】《マトリクス周辺の構成》図8は上下のガ ラス基板SUB1、SUB2を含む表示パネルPNLの 40 ラス基板SUB2とを重ね合わせ、シール材SLの開口 マトリクス (AR) 周辺の要部平面を示す図である。ま た、図9は、左側に走査回路が接続されるべき外部接続 端子G TM付近の断面を、右側に外部接続端子が無いと ころのシール部付近の断面を示す図である。

【0078】このパネルの製造では、小さいサイズであ ればスループット向上のため1枚のガラス基板で複数個 分のデバイスを同時に加工してから分割し、大きいサイ ズであれば製造設備の共用のためどの品種でも標準化さ れた大きさのガラス基板を加工してから各品種に合った サイズに小さくし、いずれの場合も一通りの工程を経て 50

からガラスを切断する。図8、図9は後者の例を示すも ので、図8、図9の両図とも上下基板SUB1、SUB 2の切断後を表しており、LNは両基板の切断前の縁を 示す。いずれの場合も、完成状態では外部接続端子群下 g、Tdおよび端子COT(添字略)が存在する(図で 上辺と左辺の) 部分はそれらを露出するように上側基板 SUB2の大きさが下側基板SUB1よりも内側に制限 されている。端子群Tg、Tdはそれぞれ後述する走査 回路接続用端子GTM、映像信号回路接続用端子DTM 10 とそれらの引出配線部を集積回路チップCHIが搭載さ れたテープキャリアパッケージTCP (図19、図2 0) の単位に複数本まとめて名付けたものである。各群 のマトリクス部から外部接続端子部に至るまでの引出配 **線は、両端に近づくにつれ傾斜している。これは、パッ** ケージTCPの配列ピッチ及び各パッケージTCPにお ける接続端子ピッチに表示パネルPNLの端子DTM、 GTMを合わせるためである。また、対向電極端子CO Tは、対向電極CTに対向電圧を外部回路から与えるた めの端子である。マトリクス部の対向電圧信号線CL 20 は、走査回路用端子G TMの反対側 (図では右側) に引 き出し、各対向電圧信号線を共通パスラインCBで一絶 めにして、対向電極端子COTに接続している。

14

【0079】透明ガラス基板SUB1、SUB2の間に はその縁に沿って、液晶封入口INJを除き、液晶LC を. 封止するようにシールパターンSLが形成される。 シール材は例えばエポキシ樹脂から成る。

【0080】配向膜ORI1、ORI2の層は、シール パターンSLの内側に形成される。偏光板POL1、P OL2はそれぞれ下部透明ガラス基板SUB1、上部透 30 明ガラス基板SUB2の外側の表面に構成されている。 液晶LCは液晶分子の向きを設定する下部配向膜ORI 1と上部配向膜ORI2との間でシールパターンSLで 仕切られた領域に封入されている。下部配向膜ORI1 は下部透明ガラス基板SUB1側の保護膜PSV1の上 部に形成される。

【0081】この液晶表示装置は、下部透明ガラス基板 SUB1側、上部透明ガラス基板SUB2側で別個に種 々の層を積み重ね、シールパターンSLを基板SUB2 側に形成し、下部透明ガラス基板SUB1と上部透明ガ 部INJから液晶しCを注入し、注入口INJをエポキ シ樹脂などで封止し、上下基板を切断することによって 組み立てられる。

【0082】《ゲート端子部》図10は表示マトリクス の走査信号線GLからその外部接続端子GTMまでの接 続構造を示す図であり、(A)は平面であり(B)は

(A) のB-B切断線における断面を示している。な お、同図は図8下方付近に対応し、斜め配線の部分は便一 宜状一直線状で表した。

【0083】図中Cr-Mo層g3は、判り易くするた

めハッチを施してある。

【0084】ゲート端子GTMはCr-Mo層g3と、 更にその表面を保護し、かつ、TCP(Tape Ca rrier Packege)との接続の信頼性を向上 させるための透明導電層 i 1 とで構成されている。この 透明導電層i1は画素電極PXと同一工程で形成された 透明導電膜ITOを用いている。

【0085】平面図において、絶縁膜GIおよび保護膜 PSV1はその境界線よりも右側に形成されており、左 端に位置する端子部GTMはそれらから露出し外部回路 10 明導電膜 i 1 は他の端子の時と同様に画素電板 P X と同 との電気的接触ができるようになっている。図では、ゲ ート線GLとゲート端子の一つの対のみが示されている が、実際はこのような対が図8に示すように上下に複数 本並べられ端子群丁g (図8) が構成され、ゲート端子 の左端は、製造過程では、基板の切断領域を越えて延長 され配線SHg (図示せず) によって短絡される。製造 過程における配向膜ORIIのラビング時等の静電破壊 防止に役立つ。

【0086】《ドレイン端子DTM》図11は映像信号 線DLからその外部接続端子DTMまでの接続を示す図 20 のB-B切断線における断面を示す。なお、同図は図5 であり、(A) はその平面を示し、(B) は(A) のB - B切断線における断面を示す。なお、同図は図8右上 付近に対応し、図面の向きは便宜上変えてあるが右端方 向が基板SUB1の上端部に該当する。

【0087】TSTdは検査端子でありここには外部回 路は接続されないが、プローブ針等を接触できるよう配 線部より幅が広げられている。同様に、ドレイン端子D TMも外部回路との接続ができるよう配線部より幅が広 げられている。外部接続ドレイン端子DTMは上下方向 にに配列され、ドレイン端子DTMは、図5に示すよう 30 同図は回路図ではあるが、実際の幾何学的配置に対応し に端子群Td (添字省略)を構成し基板SUB1の切断 線を越えて更に延長され、製造過程中は静電破壊防止の ためその全てが互いに配線SH4 (図示せず) によって 短絡される。検査端子TSTdは図11に示すように一 本置きの映像信号線DLに形成される。

【0088】ドレイン接続端子DTMは透明導電層i1 で形成されており、保護膜PSV1を除去した部分で映 像信号線DLと接続されている。この透明導電膜i1は ゲート端子G TMの時と同様に面素電極 PXと同一工程 で形成された透明導電膜ITOを用いている。

【0089】マトリクス部からドレイン端子部DTMま での引出配線は、映像信号線DLと同じレベルの層d3 が構成されている。

【0090】《対向電極端子CTM》図12は対向電圧 信号線CLからその外部接続端子CTMまでの接続を示 す図であり、(A) はその平面を示し、(B) は(A) のB-B切断線における断面を示す。なお、同図は図8 左上付近に対応する。

【0091】各対向電圧信号線CLは共通バスラインC B1で一絶めして対向電極端子CTMに引き出されてい 50 層に印加したい電圧の2倍の振幅で正極と負極を1フレ

る。共通バスラインCBは導電層g3の上に導電層3を 積層し、透明導電層 i 1 でそれらを電気的に接続した構 造となっている。これは、共通パスラインCBの抵抗を 低減し、対向電圧が外部回路から各対向電圧信号線CL に十分に供給されるようにするためである。本構造で は、特に新たに導電層を負荷することなく、共通バスラ インの抵抗を下げられるのが特徴である。

16

【0092】対向電極端子CTMは、導電層g3の上に 透明導電層 i 1 が積層された構造になっている。この透 一工程で形成された透明導電膜ITOを用いている。透 明導電層i1により、その表面を保護し、電食等を防ぐ ために耐久性のよい透明導電層 i 1 で、導電層 g 3 を覆 っている。また透明草電層 i 1 と導電層 g 3 および導電 層 d 3 との接続は保護膜PSV1および絶縁膜GIにう スルーホールを形成し導通を取っている。

【0093】一方、図13は対向電圧信号線CLのもう 一方の端からその外部接続端子CTM2までの接続を示 す図であり、(A)はその平面を示し、(B)は(A) 右上付近に対応する。ここで、共通バスラインCB2で は各対向電圧信号線CLのもう一方の端(ゲート端子G TM側)をで一纏めして対向電極端子CTM2に引き出 されている。共通バスラインCB1と異なる点は、走査 信号線G L とは絶縁されるように、導電層 d 3 と透明導 電層 i 1 で形成していることである。また、走査信号線 GLとの絶縁は絶縁膜GIで行っている。

【0094】《表示装置全体等価回路》表示マトリクス 部の等価回路とその周辺回路の結線図を図14に示す。 て描かれている。ARは複数の画素を二次元状に配列し たマトリクス・アレイである。

【0095】図中、Xは映像信号線DLを意味し、添字 G、BおよびRがそれぞれ緑、青および赤画素に対応し て付加されている。Yは走査信号線GLを意味し、添字 1、2、3、…、endは走査タイミングの順序に従って 付加されている。

【0096】走査信号線Y(添字省略)は垂直走査回路 Vに接続されており、映像信号線X(添字省略)は映像 40 信号駆動回路Hに接続されている。

【0097】SUPは1つの電圧源から複数の分圧した 安定化された電圧額を得るための電源回路やホスト(上 位演算処理装置)からのCRT(陰極線管)用の情報を TFT液晶表示装置用の情報に交換する回路を含む回路 である。

【0098】《駆動方法》。図15に本実施例の液晶表示 装置の駆動波形を示す。対向電圧Vcは一定電圧とす る。走査信号Vgは1走査期間ごとに、オンレベルをと り、その他はオフレベルをとる。映像信号電圧は、液晶

ーム毎に反転して1つの画素に伝えるように印加する。 ここで、映像信号電圧Vdは1列毎に極性を反転し、2 行毎にも極性を反転する。これにより、極性が反転した 画案が上下左右にとなりあう構成となり、フリッカ、ク ロストーク(スミア)を発生しにくくすることができ る。また、対向電圧Vcは映像信号電圧の極性反転のセ ンター電圧から、一定量さげた電圧に設定する。これ は、薄膜トランジスタ素子がオンからオフに変わるとき に発生するフィードスルー電圧を補正するものであり、 液晶に直流成分の少ない交流電圧を印加するために行 う。液晶は直流が印加されると、残像、劣化等が激しく

【0099】また、この他に、対向電圧は交流化するこ とで映像信号電圧の最大振幅を低減でき、映像信号駆動 回路 (信号側ドライバ) に耐圧の低いものを用いること も可能である。

【0100】《蓄積容量Cstgの働き》蓄積容量Cstg は、面素に書き込まれた(薄膜トランジスタTFTがオ フした後の) 映像情報を、長く蓄積するために設ける。 本発明で用いている電界を基板面と平行に印加する方式 20 では、電界を基板面に垂直に印加する方式と異なり、画 素電極と対向電極で構成される容量(いわゆる液晶容 量) がほとんど無いため、蓄積容量Cstgが映像情報を 画素に蓄積することができない。したがって、電界を基 板面と平行に印加する方式では、蓄積容量Cstgは必須 の構成要素である。

【0101】また、蓄積容量Cstgは、薄膜トランジス タTFTがスイッチングするとき、画素電極電位Vsに 対するゲート電位変化ΔVgの影響を低減するようにも 働く。この様子を式で表すと、次のようになる。 [0102]

 $\Delta Vs = \{Cgs/(Cgs+Cstg+Cpix)\} \times \Delta Vg$ ここで、Cgsは薄膜トランジスタTFTのゲート電極G Tとソース電極SD1との間に形成される寄生容量、C pixは画素電極PXと対向電極CTとの間に形成される 容量、ΔVsはΔVgによる画素電極電位の変化分いわゆ るフィードスルー電圧を表わす。この変化分ΔVsは液 晶しCに加わる直流成分の原因となるが、保持容量Cst gを大きくすればする程、その値を小さくすることがで きる。液晶LCに印加される直流成分の低減は、液晶L Cの寿命を向上し、液晶表示画面の切り替え時に前の画 像が残るいわゆる焼き付きを低減することができる。

【0103】前述したように、ゲート電極GTはi型半 導体層ASを完全に覆うよう大きくされている分、ソー ス電極SD1、ドレイン電極SD2とのオーバラップ面 積が増え、従って寄生容量Cgsが大きくなり、画素電極 電位Vsはゲート(走査)信号Vgの影響を受け易くなる という逆効果が生じる。しかし、蓄積容量Cstgを設け ることによりこのデメリットも解消することができる。

置の基板SUB1側の製造方法について図16~図18 を参照して説明する。なお同図において、中央の文字は 工程名の略称であり、左側は図27に示す薄膜トランジ スタTFT部分、右側は図10に示すゲート端子付近の 断面形状でみた加工の流れを示す。工程B、工程Dを除 き工程A~工程Iは各写真処理に対応して区分けしたも ので、各工程のいずれの断面図も写真処理後の加工が終 わりフォトレジストを除去した段階を示している。な お、写真処理とは本説明ではフォトレジストの塗布から マスクを使用した選択露光を経てそれを現像するまでの 一連の作業を示すものとし、繰返しの説明は避ける。以 下区分けした工程に従って、説明する。

18

【0105】工程A、図16

AN635ガラス(商品名)からなる下部透明ガラス基 板SUB1上に膜厚が2000ÅのCr-Mo等からな る導電膜g3をスパッタリングにより設ける。写真処理 後、硝酸第2セリウムアンモンで導電膜 g 3を選択的に エッチングする。それによって、ゲート電極GT、走査 信号線GL、対向電圧信号線CL、ゲート端子GTM、 共通パスラインCB1の第1導電層、対向電極端子CT M1の第1導電層、ゲート端子GTMを接続するパスラ インSHg(図示せず)を形成する。

【0106】工程B、図16

プラズマCVD装置にアンモニアガス、シランガス、窒 素ガスを導入して、膜厚が3500Aの窒化Si膜を設 け、プラズマCVD装置にシランガス、水素ガスを導入 して、膜厚が1200Åのi型非晶質Si膜を設けたの ち、プラズマCVD装置に水索ガス、ホスフィンガスを 導入して、膜厚が300AのN(+)型非晶質Si膜を設 30 ける。

【0107】工程C、図16

写真処理後、ドライエッチングガスとして S F 6、C C 14を使用してN(+)型非晶質Si膜、i型非晶質Si 膜を選択的にエッチングすることにより、 i 型半導体層 ASの島を形成する。

【0108】工程D、図17

膜厚が300AのCrからなる導電膜d3をスパッタリ ングにより設ける。写真処理後、導電膜 d 3 を工程Aと 同様な液でエッチングし、映像信号線DL、ソース電極 40 SD1、ドレイン電板SD2、共通バスラインCB2の 第1導電層,およびドレイン端子DTMを短絡するバス ラインSHd(図示せず)を形成する。つぎに、ドライ エッチング装置にCC14、SF6を導入して、N(+)型 非晶質Si膜をエッチングすることにより、ソースとド レイン間のN(+)型半導体層 d Oを選択的に除去する。 導電膜d3をマスクパターンでパターニングした後、導 電膜 d 3 をマスクとして、N(+)型半導体層 d O が除去 される。つまり、i型半導体層AS上に残っていたN (+)型半導体層 d O は導電膜 d 1、導電膜 d 2以外の部 【0104】《製造方法》つぎに、上述した液晶表示装 50 分がセルフアラインで除去される。このとき、N(+)型

半導体層d0はその厚さ分は全て除去されるようエッチ ングされるので、i型半導体層ASも若干その表面部分 がエッチングされるが、その程度はエッチング時間で制 御すればよい。

【0109】工程E、図17

プラズマCVD装置にアンモニアガス、シランガス、窒 素ガスを導入して、膜厚が 0.4 μ m の窒化 S i 膜を設 ける。写真処理後、ドライエッチングガスとしてSF6 を使用して窒化Si膜を選択的にエッチングすることに よって、保護膜PSV1および絶縁膜GIをパターニン 10 パネルPNL側の接続端子GTMを露出した保護膜PS グする。ここで、保護膜PSV1と絶縁膜GIは同一ホ トマスクでパターニングされ、一括で加工される。

【0110】工程F、図18

膜厚が1400ÅのITO膜からなる透明導電膜i1を スパッタリングにより設ける。写真処理後、エッチング 液として塩酸と硝酸との混酸液で透明導電膜 i 1を選択 的にエッチングすることにより、ゲート端子GTMの最 上層、ドレイン端子DTMおよび対向電極端子CTM1 およびCTM2の第2導電層を形成する。

【0111】《表示パネルPNLと駆動回路基板PCB 1》図19は、図8等に示した表示パネルPNLに映像 信号駆動回路Hと垂直走査回路Vを接続した状態を示す 上面図である。

【0112】CHIは表示パネルPNLを駆動させる駆 動ICチップ(下側の5個は垂直走査回路側の駆動IC チップ、左の10個ずつは映像信号駆動回路側の駆動1 Cチップ) である。 TCPは図16、図17で後述する ように駆動用ICチップCHIがテープ・オートメイテ ィド・ボンディング法 (TAB) により実装されたテー プキャリアパッケージ、PCB1は上記TCPやコンデ 30 コネクタ接続部である。 ンサ等が実装された駆動回路基板で、映像信号駆動回路 用と走査信号駆動回路用の2つに分割されている。FG Pはフレームグランドパッドであり、シールドケースS HDに切り込んで設けられたパネ状の破片が半田付けさ れる。FCは下側の駆動回路基板PCB1と左側の駆動 回路基板 PCB 1 を電気的に接続するフラットケーブル である。フラットケーブルFCとしては図に示すよう に、複数のリード線(りん青銅の素材にSn鍍金を施し たもの) をストライプ状のポリエチレン層とポリビニル アルコール層とでサンドイッチして支持したものを使用 40 RMは反射板、BLはパックライト蛍光管、LCAはバ

【0113】《TCPの接続構造》図20は走査信号駆 動回路Vや映像信号駆動回路Hを構成する、集積回路チ ップCHIがフレキシブル配線基板に搭載されたテープ キャリアパッケージTCPの断面構造を示す図であり、 図21はそれを液晶表示パネルの、本例では走査信号回 路用端子GTMに接続した状態を示す要部断面図であ

【0114】同図において、TTBは集積回路CHIの 入力端子・配線部であり、TTMは集積回路CHIの出 50 の側面に配置されたバックライト蛍光管BLの光を、導

力端子・配線部であり、例えばCuから成り、それぞれ の内側の先端部 (通称インナーリード) には集積回路 C HIのボンディングパッドPADがいわゆるフェースダ ウンボンディング法により接続される。端子TTB、T TMの外側の先端部 (通称アウターリード) はそれぞれ 半導体集積回路チップCHIの入力及び出力に対応し、 半田付け等によりCRT/TFT変換回路、電源回路S UPに、異方性導電膜ACFによって液晶表示パネルP NLに接続される。パッケージTCPは、その先端部が V1を覆うようにパネルに接続されており、従って、外 部接続端子GTM (DTM) は保護膜PSV1かパッケー ジTCPの少なくとも一方で覆われるので電触に対して 強くなる。

【0115】 BF1はポリイミド等からなるベースフィ ルムであり、SRSは半田付けの際半田が余計なところ へつかないようにマスクするためのソルダレジスト膜で ある。シールパターンSLの外側の上下ガラス基板の隙 間は洗浄後エポキシ樹脂EPX等により保護され、パッ 20 ケージTCPと上側基板SUB2の間には更にシリコー ン樹脂SILが充填され保護が多重化されている。

【0116】《駆動回路基板PCB2》駆動回路基板P CB2は、IC、コンデンサ、抵抗等の電子部品が搭載 されている。この駆動回路基板PCB2には、1つの電 圧顔から複数の分圧した安定化された電圧源を得るため の電源回路や、ホスト(上位演算処理装置)からのCR T (陰極線管) 用の情報をTFT液晶表示装置用の情報 に変換する回路を含む回路SUPが搭載されている。C 」は外部と接続される図示しないコネクタが接続される

【0117】駆動回路基板PCB1と駆動回路基板PC B2とはフラットケーブルFCにより電気的に接続され ている。

【0118】《液晶表示モジュールの全体構成》図22 は、液晶表示モジュールMDLの各構成部品を示す分解 斜視図である。

【0119】SHDは金属板から成る枠状のシールドケ ース(メタルフレーム)、LCWその表示窓、PNLは 液晶表示パネル、SPBは光拡散板、LCBは導光体、 ックライトケースであり、図に示すような上下の配置関 係で各部材が積み重ねられてモジュールMDLが組み立 てられる。

【0120】モジュールMDLは、シールドケースSH Dに設けられた爪とフックによって全体が固定されるよ うになっている。

【0121】バックライトケースLCAはバックライト 蛍光管BL、光拡散板SPB光拡散板、導光体LCB、 反射板RMを収納する形状になっており、導光体LCB

光体LCB、反射板RM、光拡散板SPBにより表示面 で一様なパックライトにし、液晶表示パネルPNL側に

【O122】バックライト蛍光管BLにはインパータ回 路基板PCB3が接続されており、パックライト蛍光管 BLの電顔となっている。

[0123]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 高コントラスト比、かつ、広視野角特性を得られると同 時に、高面質を維持できる高信頼性を両立した液晶表示 10 る。 装置を得ることができる。

【0124】また、同時に、応答速度が極めて速く、低 電圧で駆動可能な液晶表示装置も得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を示す断面図である。

【図2】本発明の原理を示す平面図である。

【図3】本発明の印加電界方向、偏光板透過軸の関係を 示す図である。

【図4】本発明の実施例のアクティブ・マトリックス型 示す要部平面図である。

【図5】図4の6-6切断線における画素の断面図であ る。

【図6】図4の7-7切断線における薄膜トランジスタ 素子TFTの断面図である。

【図7】図4の8-8切断線における蓄積容量Cstgの 断面図である。

【図8】表示パネルのマトリクス周辺部の構成を説明す るための平面図である。

【図9】左側に走査信号端子、右側に外部接続端子の無 30 いパネル緑部分を示す断面図である。

【図10】ゲート端子GTMとゲート配線GLの接続部 近辺を示す平面と断面の図である。

【図11】ドレイン端子DTMと映像信号線DLとの接 統部付近を示す平面と断面の図である。

【図12】共通電極端子CTM1、共通バスラインCB 1および共通電圧信号線CLの接続部付近を示す平面と 断面の図である。

【図13】共通電極端子CTM2、共通パスラインCB

22

2および共通電圧信号線 CLの接続部付近を示す平面と 断面の図である。

【図14】本発明のアクティブ・マトリックス型カラー 液晶表示装置のマトリクス部とその周辺を含む回路図で

【図15】本発明のアクティブ・マトリックス型カラー 液晶表示装置の駆動放形を示す図である。

【図16】基板SUB1側の工程A~Cの製造工程を示 す画素部とゲート端子部の断面図のフローチャートであ

【図17】基板SUB1側の工程D~Fの製造工程を示 す画素部とゲート端子部の断面図のフローチャートであ

【図18】 基板SUB1側の工程G~Hの製造工程を示 す面素部とゲート端子部の断面図のフローチャートであ

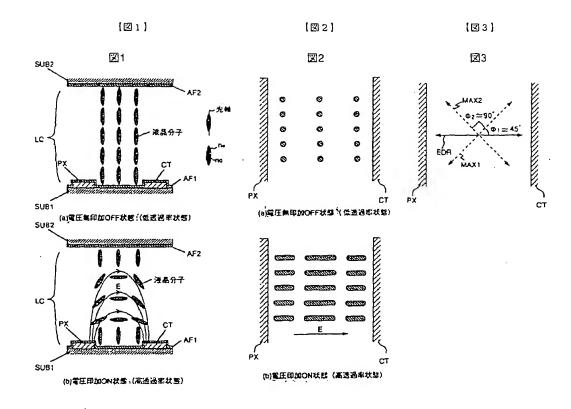
【図19】液晶表示パネルに周辺の駆動回路を実装した 状態を示す上面図である。

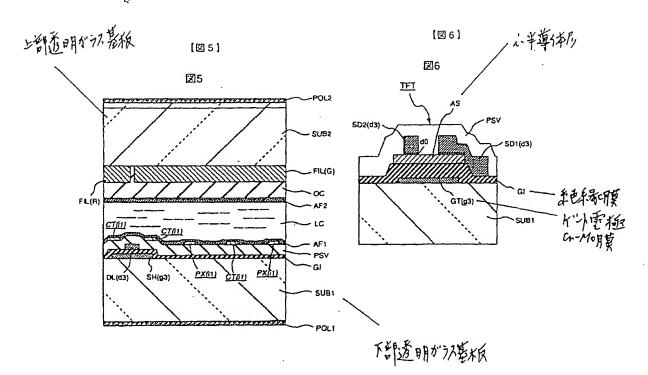
【図20】駆動回路を構成する集積回路チップCHIが カラー液晶表示装置の液晶表示部の一面素とその周辺を 20 フレキシブル配線基板に搭載されたテープキャリアパッ ケージTCPの断面構造を示す図である。

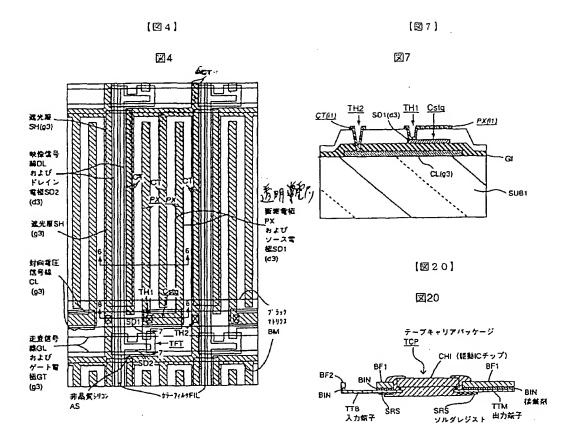
> 【図21】テープキャリアパッケージTCPを液晶表示 パネルPNLの走査信号回路用端子GTMに接続した状 態を示す要部断面図である。

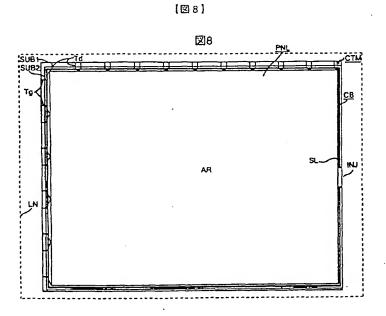
【図22】液晶表示モジュールの分解斜視図である。 【符号の説明】

SUB…透明ガラス基板、GL…走査信号線、DL…映 像信号線、CL…対向電圧信号線、PX…画素電極、C T…対向電極、GI…絶縁膜、GT…ゲート電極、AS … i 型半導体層、SD…ソース電極またはドレイン電 極、PSV…保護膜、BM…遮光膜、LC…液晶、TF T…薄膜トランジスタ、PH…スルーホール、g、d… 導重膜、Cstg…蓄積容量、AOF…楊極酸化膜、AO …陽極酸化マスク、G TM…ゲート端子、D TM…ドレ イン端子、CB…共通パスライン、DTM…共通電極端 子、SHD…シールドケース、PNL…液晶表示パネ ル、SPB···光拡散板、LCB···導光体、BL···パック ライト蛍光管、LCA…バックライトケース、RM…反 射板、(以上添字省略)。



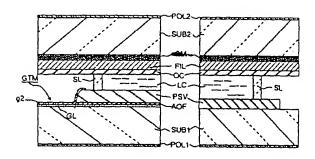






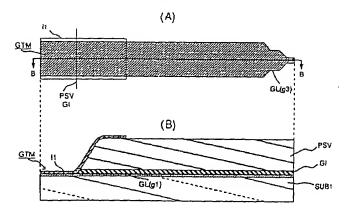
【図9】

図9



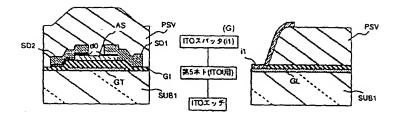
[図10]

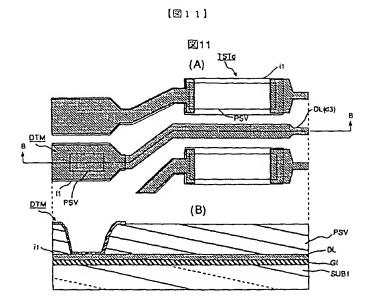
⊠10

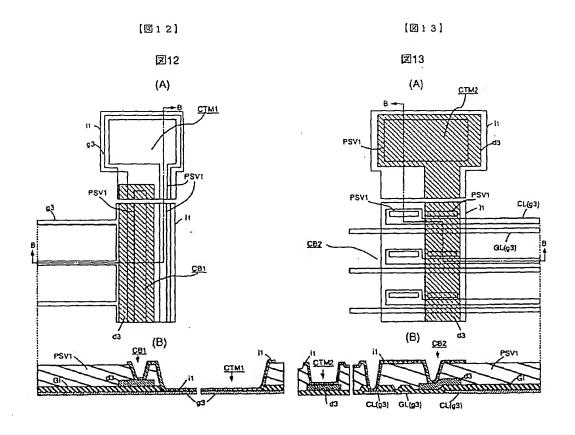


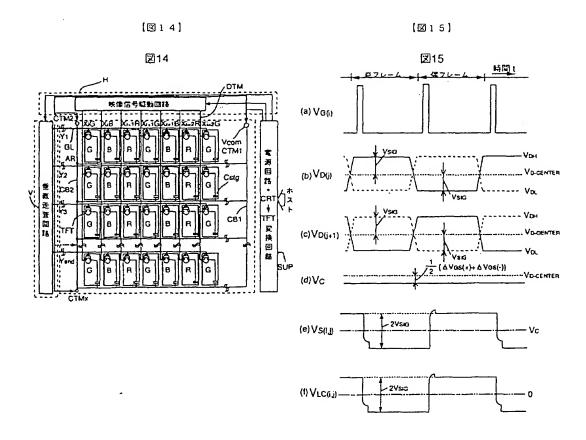
[図18]

図18





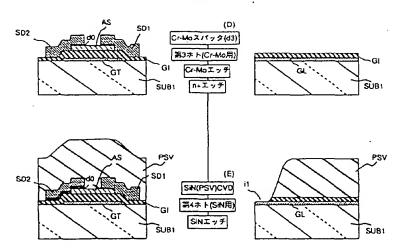




[図16]

【図17】

図17

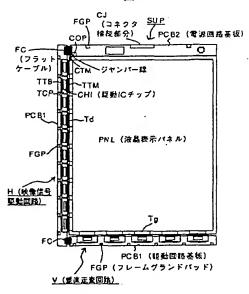


[図19]

the survey of the state of the same of

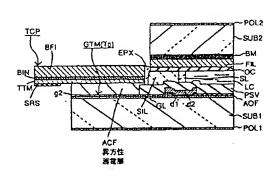
_ - - .

図19



[図21]

図21



[图22]

